

INTERCONNECTS 1mm Grid Surface Mount Connectors **Male and Female Connectors**

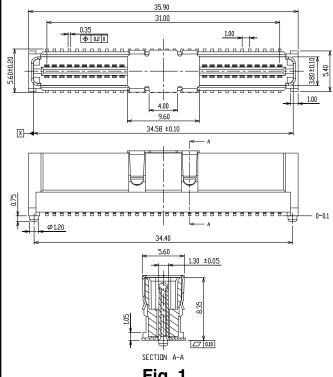
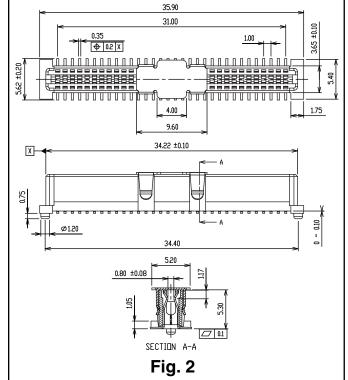
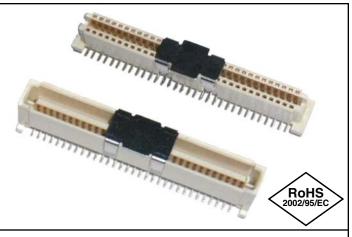


Fig. 1



31.00 Ø1.40 ±0.03 ±0.05 ф 0.1 В 9,00 34.40 ±0.05 В RECOMMENGED P.C. BOARD LAYOUT



Features:

- 64 Position Mezzanine connectors for board stacking.
- 1 mm Centerline high density packaging.
- Mated connector board stacking height of 10 mm.
- Conforms to EIA-700 AAAB for IEEE 1386 applications.
- Suitable for "lead free" reflow soldering (260° C peak).
- Tape & Reel packaged per EIA-783 (56 mm wide; 16 mm pitch).

Ordering Information:

Figure 1: 1mm Surface Mount Male Connector

891-10-064-30-120000

Packaging: 400 Parts per 13" reel

Figure 2: 1mm Surface Mount Female Connector

893-43-064-30-420000

Packaging: 600 Parts per 13" reel

Specifications:

Materials:

Terminals & Contacts: Phosphor Bronze Plating: Contact area - 30 μ " Gold over nickel Solder Terminals - 75 µ" Tin over nickel

Vacuum Cap: Stainless Steel

Insulator Material: High temperature glass filled LCP, rated UL 94V-0

Ratings:

Current: (30° C Temperature Rise): 0.5 A max., all circuits wired in series (1.0A max., five adjacent circuits wired in series) Voltage: 250V AC (RMS) (contact to contact)

Operating Temperature range: -55° C - +85° C

Electrical:

Contact resistance: $30m\Omega$ max. Insulation resistance: 1.000 M Ω min.

Dielectric Withstanding Voltage: 250V AC for one minute@sea level

Vibration: No discontinuity > 1 μs per MIL-STD 202, Method 201 Physical Shock: No discontinuity > 1 μs per EIA 364-27 Test Condition H

Durability: 100 Cycles min. per EIA 364-09

Mating Force: 60 g/terminal max. per EIA 364-13 Separation Force: 23 g/terminal min. per EIA 364-13

Contact Retention Force: .4Kg min. per EIA 364-35

Environmental:

Thermal Shock: Per EIA 364-32, Test Condition I

Humidity: Test conditions - Ambient temp. 40±2°C; Relative

humidity: 90 - 95%; Duration: 96 Hrs.

Post Humidity inspection - 1. No damage

2. Contact resistance change $< 15 \text{ m}\Omega$

3. Insulation Resistance: 100 M Ω min.

Solderability: Per EIA 364-52 Category 2

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9